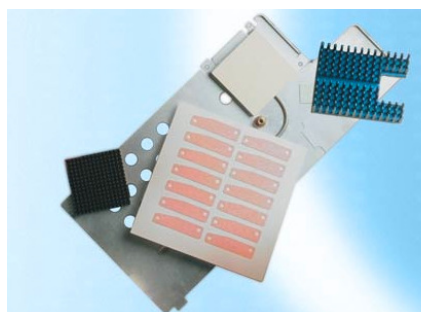




***Ready for 5G**

PRODUCT DESCRIPTION

Tpli™ 200 is a premium gap filler. A unique blend of boron nitride and silicone produce the highest performing interface pad.

Tpli 200's exceptional combination of high thermal conductivity and compliancy generate unmatched thermal resistances in a gap filling interface material.

Tpli 200 absorbs shock and relieves stresses, thus minimizing potential damage to components. Tpli 200 is electrically insulating, stable from -45°C to 200°C, and meets UL 94 HB rating.

FEATURES AND BENEFITS

- Soft and compliant
- High Thermal performance
- Environmentally friendly solution that meets regulatory requirements including RoHS and REACH

SPECIFICATIONS

TYPICAL PROPERTIES	TYPICAL VALUE	TEST METHOD
Construction & Composition	Boron nitride filled silicone sheet	N/A
Color	Varies by thickness	Visual
Thickness Range	0.25mm (0.010") - 5.08mm (0.20")	N/A
Thickness Tolerance	+/- 10%	N/A
Thermal Conductivity (W/mK)	6.0	ASTM D5470
Density (g/cc)	1.4	Helium Pycnometer
Hardness (Shore 00)	70	ASTM D2240
Outgassing TML (weight %)	0.51	ASTM E595
Outgassing CVM (weight %)	0.17	ASTM E595
Temperature Range	-45°C to 200°C	N/A
Rth@ 40 mils, 10 psi, 50°C	0.25°C-in ² /W	ASTM D5470 (modified)
* Dielectric Constant @ 10GHz	3.2 *	ASTM D150
UL Flammability Rating	HB	UL 94
Volume Resistivity	5x10 ¹³ ohm-cm	ASTM D257



Tpli 200 Series

Thermal Gap Filler

AVAILABILITY

STANDARD THICKNESSES

- 0.25mm (0.010") to 5.0mm (0.200") thick material available in 0.25mm (0.010") increments
- Available in standard sheet sizes of 18" x 18" and 9" x 9" or custom die cut parts

REINFORCEMENT

- Fiberglass is required in thicknesses of 0.010" (0.25mm) and 0.015" (0.38mm)
- Reinforcement is optional in thicknesses 0.020" (0.5mm) and 0.025" (0.63mm). Indicate fiberglass by "FG" suffix
- Thicknesses above 0.025" (0.63mm) are not reinforced

OPTIONS

- A0 - no adhesive
- A1 – adhesive on one side

POST CURE

- Post Curing option available. Indicate fiberglass by "PC" suffix

PART NUMBER SYSTEM

Tflex™ indicates Laird elastomeric thermal gap filler product line. Tpli 2xx indicates Tpli 200 product line with thickness in mils (0.001")

EXAMPLES:

- Tpli 240,A0 = 0.040 inch thick Tpli™ 200 material with no adhesive
- Tpli 280,A1 = 0.080 inch thick Tpli™ 200 material with one side adhesive
- Tpli 220FG,A1 = 0.020 inch thick Tpli™ 200 material with fiberglass reinforcement and one side adhesive
- Tpli 260,PC = 0.060 inch thick Tpli™ 200 material post cured

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru